PowerPoint

电子科技大学

电装实习课程

电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of China

装配工艺原则

电子产品的电气连接，是通过对元器件的装配与焊接来实现的。

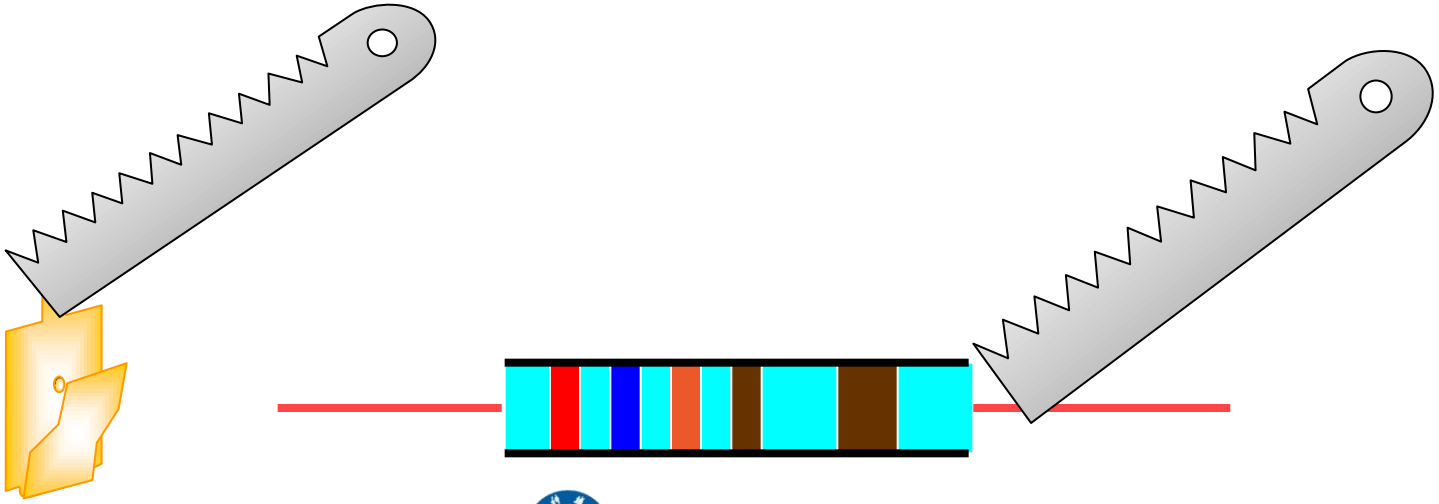
装配与焊接技术并不复杂，但产品的装配过程是否合理，焊接质量是否可靠，对整机性能指标的影响是很大的。

在电子产品装配、焊接以前，要进行一些准备：

1、去氧化层
2、确认读数
3、元件弯制
4、元件插放

清除元件表面氧化层

左手捏住电阻或其他元件的本体，右手用锯条轻刮元件脚的表面，左手慢慢地转动，直到表面氧化层全部去除。



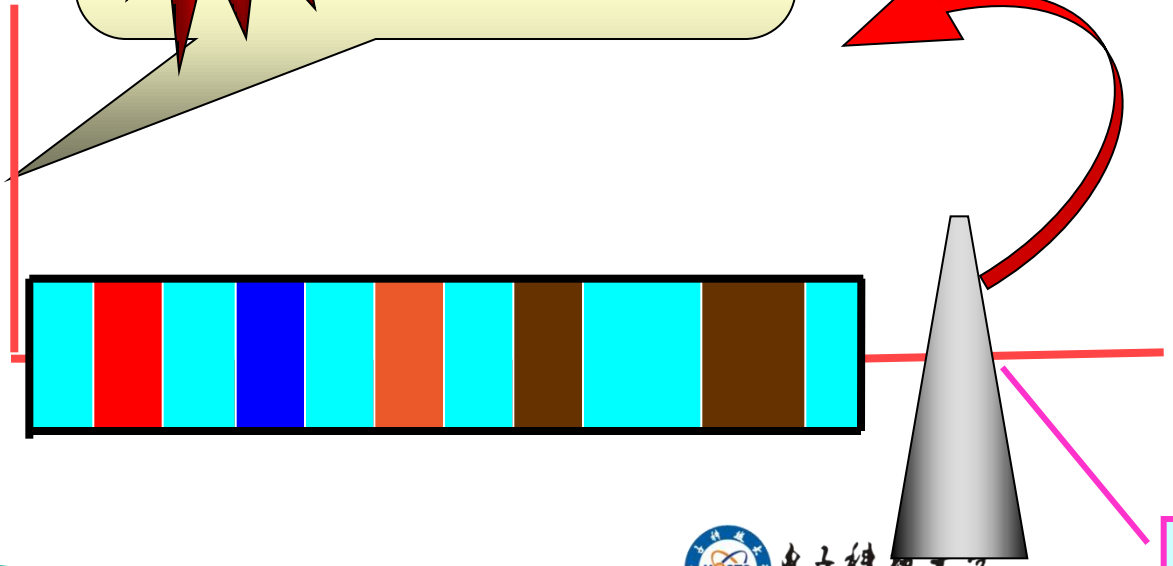
元件脚的弯制成形1

错

直接从元件根部，将元件脚弯制成形

yes

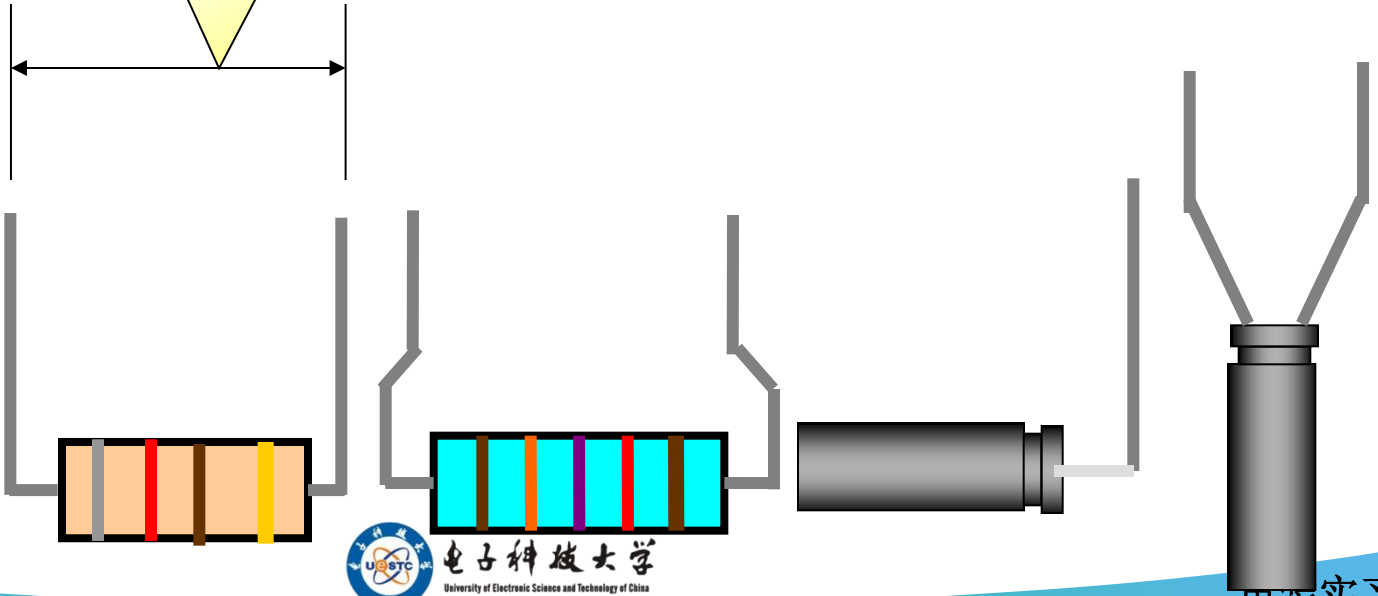
用镊子夹住元件根部，将元件脚 弯制成形



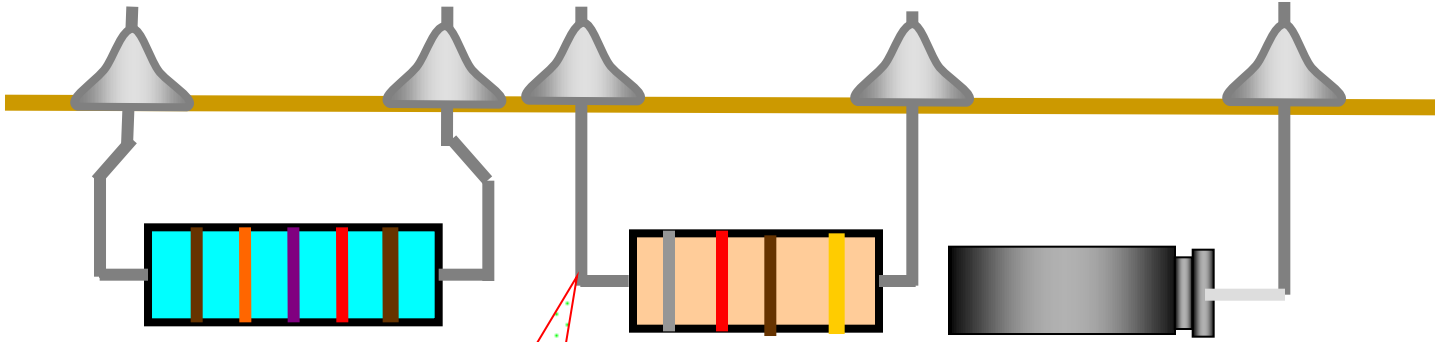
镊子

元件脚的弯制成形2

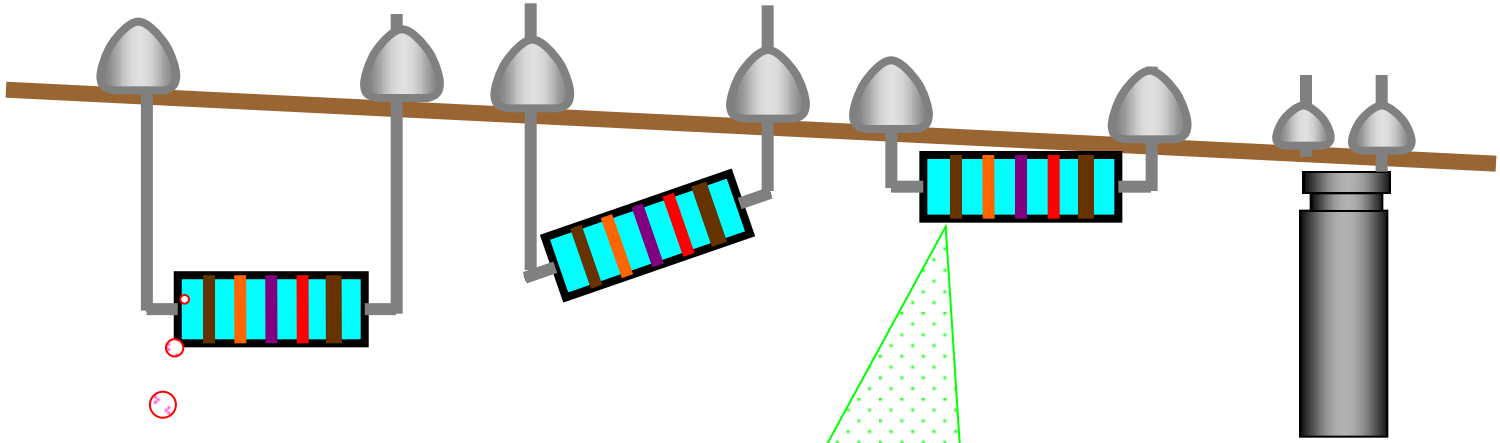
根据印刷电路孔距而定



元件的插放



Space=1～5mm.



太高

太低，剪太短

最后再焊，否则别的都放不整齐

安装元器件要注意以下几点：

1、装配时，应该先安装那些需要机械固定的元器件，再安装靠焊接固定的元器件
2、元器件的安装方向，应该是有标记的朝上或朝着容易辨认的方向
3、有极性的元器件要保证方向正确

安装顺序

由小到大，从低到高，由简单到复杂，由一般元器件到精密元器件。

Thank You !

电装实习课程组

电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of China